

# 3EC-M3S-HTE

- ・ 圧延銅箔同様にアニールにより再結晶する高伸び・高屈曲電解銅箔。  
High Elongation and flexibility after annealing, equally with RA copper foil.
- ・ S面に表面処理を行い、3EC-HTEよりも低粗度を実現。  
Lower profile compare with 3EC-HTE because of S-side surface treatment.
- ・ 2011年より日本だけでなく台湾・マレーシア拠点でも一部生産開始し、安定供給が可能です。  
Stable supply is available because of 3-factory-production.

## 用途/Application

- ・フレキシブルプリント基板  
/Flexible Print Board

## 構成/Composition



## 生産拠点/Production Site

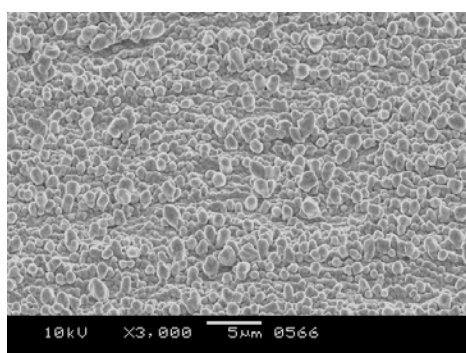
- ・日本/Japan
- ・マレーシア/Malaysia

## 代表的特性値/Representative data

	$\mu\text{m}$	Area weight (g/m <sup>2</sup> )	Laminate side Rz( $\mu\text{m}$ )	Tensile Strength (N/mm <sup>2</sup> )	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm) <sup>@FR-4</sup>
3EC-M3S-HTE	12	107	2.5	390	6	0.8
	18	153	2.5	390	10	0.9

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。  
This is representative data, not guarantee.

ラミ面/Laminate side



レジ面 resist side

